

中信证券股份有限公司

关于有研半导体硅材料股份公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股面值1.00元，每股发行价格为9.91元。本次公开发行募集资金总额为185,458.87万元，扣除总发行费用19,062.15万元（不含增值税），募集资金净额为166,396.72万元。上述募集资金已全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到账情况进行了审验，并于2022年11月7日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

截至2022年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	1,677,685,319.55
减：本年度投入募集资金总额	3,987,662.74
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	884,824,300.00
减：支付的其他发行费用	8,384,905.65
加：本年度募集资金专项账户的利息收入扣除手续费净额	3,919,315.50
募集资金专项账户年末余额	784,407,766.66

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构中信证券及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已开立的募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	426,225,544.53	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	358,182,222.13	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	-	不适用
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	-	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	-	不适用

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司 2022 年度不存在募投项目的预先投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 11 月 17 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 166,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	余额	是否如期归还
中国民生银行北京东单支行	结构性存款	500,000,000.00	未到期
中国工商银行北京航天城支行	七天通知存款	384,824,300.00	提前七天通知解付

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2022 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2022 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2022 年度不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已及时、真实、准确、完整地披露对募集资金使用及管理情况进行披露。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《有研半导体硅材料股份公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》(些马威华振专字第 2300400 号)，认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规中的相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过获取资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对有研硅首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：2022 年度有研硅对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，公司 2022 年度不存在募集资金投向变更的情况；具体使用情况与已披露情况一致，未发现首次公开发行股票募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变上述募集资金用途和损害股东利益的情形。

(以下为本报告附表)

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额(注 1)					1,663,967,265.37			本年度投入募集资金总额		3,987,662.74			
变更用途的募集资金总额					-			已累计投入募集资金总额		3,987,662.74			
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）（注 2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充研发与运营资金	无	25,782.81	25,782.81	25,782.81	398.77	398.77	-25,384.04	1.55	不适用	不适用	不适用	否	
集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	无	38,482.43	38,482.43	38,482.43	-	-	-38,482.43	-	未到期	不适用	不适用	否	
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	无	35,734.76	35,734.76	35,734.76	-	-	-35,734.76	-	未到期	不适用	不适用	否	
超募资金	无	不适用	663,967,265.37	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	
合计		100,000.00	166,396.73	100,000.00	398.77	398.77	-99,601.23	-					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2022 年度未发生此情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于 2022 年度未发生此情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于 2022 年度未发生此情况								

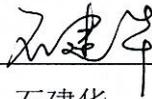
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2022 年度未发生此情况
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年度未发生此情况

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元。

注 2：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


石建华


李钦佩

